

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-017

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	西部证券 2 人，浙商证券 1 人，粤科创投 1 人，国信创投 1 人，共 5 人。
时间	2025 年 6 月 13 日
地点	公司会议室
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书任怡
交流内容及具体问答记录	<p>一、回答投资者提问：</p> <p>1、请问公司二季度经营情况？</p> <p>回答：</p> <p> 公司目前订单饱满，二季度以来的产能利用率保持了较高的水平。</p> <p>2、请问汽车电子业务的发展前景？</p> <p>回答：</p> <p> 汽车电子业务是公司战略发展的重要业务领域之一。通过不断深入探索产品组合，截止目前，公司汽车电子产品已实现三电系统等电动化场景全面覆盖，并延伸至智能驾驶、智能座舱等全方位智能化应用场景覆盖。产品线不断拓宽，车载专用的各类变压器产品、功率类电感产品、磁环、车用陶瓷产品等均得到行业大客户的认可。</p> <p> 公司持续看好汽车电子领域的发展前景，未来，随着汽车电子业务新产品导入加速，新应用拓展，各类提前布局的车载应用及产品持续拓展和推广、核心大客户市场份额继续</p>

提升，公司在汽车电子领域的发展将持续保持健康增长态势。

3、请问服务器、数据中心的产品拓展情况？

回答：

数据中心是公司战略布局新兴战略市场之一，目前可为客户供应各类型的一体成型功率电感、组装式功率电感、超薄铜磁共烧功率电感、钽电容产品等，并为客户定制配套的产品解决方案。

开年来公司应用于数据中心电源管理领域的各类模压平台功率电感销售增速提升明显，客户进展顺利。公司密切与头部企业保持合作与联系，凭借自身的工艺平台多样性，在AI服务器、DDR5、企业级SSD等应用场景为客户提供了多种节能降耗的产品组合与方案。

4、请问AI手机对公司业务的拉动情况？

回答：

手机通讯应用领域是公司的传统优势市场，国内市场份额占比较高。公司不断投入研发力量，持续推出具有竞争力的新产品，推动新产品快速增长，份额快速提升。

从目前智能终端的发展趋势看，手机增加AI功能，对元器件、尤其是功率类电感产品的需求量进一步提升（用量的提升）；更大功率的应用场景和散热等参数需求，拉动对高端元器件的需求（价的提升），价和量的需求带动了手机单机元器件价值的提升。公司相关产品已受益于行业趋势。

5、请介绍一下公司一体成型电感产品的情况？

回答：

一体成型功率电感是公司重点开发的产品项目，经过公司前期多年持续研发投入，积极参与大客户应用项目，市场空间持续打开，增长速度快，应用市场覆盖面广，市场空间需求量大，未来前景可期。一体成型功率电感属于功率电感大类，在功率电感领域，公司具有业界品类最全、业界领先的设计、制造平台：

(1) 叠层平台功率电感适合制造超小、超薄尺寸功率电感，主要面向手机、智能穿戴、模块芯片等功率1-10W的应用场景；

(2) 涂覆平台功率电感可制造的产品尺寸、感量范围非常广，性价比高，主要面向手机、家电、安防、车载等功率5-50W的应用场景；

(3) 组装平台功率电感适合制造中大尺寸、大电流功率电感，主要面向服务器、工业等功率50W以上的应用场景；

(4) 模压平台功率电感可制造的产品尺寸、感量范围较广，主要应用于手机、PC、车载、服务器等功率5-2000W的应用场景。其中超低压平台功率电感以其卓越的低损耗、高可靠性优势，在高端消费电子、DDR5、电源模块等领域得到客户青睐；铜磁共烧平台电感凭借领先的高功率密度特性，在AI服务器领域颇受好评。

公司对应不同细分市场客户及应用，为客户提供全面、系统、性价比高的功率电感解决方案。

6、请问公司所处的行业的竞争格局？

回答：

公司所在电子元器件行业属于重资本投入行业,对于初期投资要求较高,资本投入壁垒、技术壁垒、工艺壁垒、质量壁垒较高,市场门槛较高,客户的要求也高,公司已为行业细分龙头企业,产品综合核心竞争力较强,目前主要竞争对手系日本厂商。

经过公司二十多年来的专注发展,在基础元件领域确立了综合的核心竞争优势,包括技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势;核心产品确立了全球交付优势,获得了全球重量级客户群信赖,与客户合作深度和广度持续提升;公司依托全球优质大客户,持续进行技术创新,同时不断提升产能和开发新产品,成为全球供应链的优选供应商是公司发展使命。

公司已经逐步实现从行业跟随者向行业引领者转型,公司将会持续资本投入及研发投入,整合内外部资源,不断推出更有核心竞争力的产品,实现公司“成为电子元器件领域

	<p>专家”的企业愿景。</p> <p>7、请问今年计划的资本开支水平，是否有直接融资计划？</p> <p>回答：</p> <p>（1）公司本身所处行业属于重资本投入行业，每年均有持续扩产需求，对资金需求较高（高资本投入同时也是行业壁垒）；</p> <p>（2）公司仍处于持续成长阶段，新业务新领域的快速发展，需要持续投入产能；</p> <p>（3）公司十分重视研发投入（公司研发投入包括研发费用和研发设备投入），每年均持续投入较高比例研发资金，研发支出长期看处于持续增长态势；</p> <p>（4）近几年公司资本开支的重要组成部分为工业园基础建设投入，随着三个工业园和研发中心相继完工，未来几年以园区基建为主的投资将会明显放缓；</p> <p>（5）关于资本市场融资方面，后续将根据公司具体投资进度来规划资金需求，制定合适的融资计划，短期内暂不考虑采取资本市场直接融资方案。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及应披露重大信息</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>